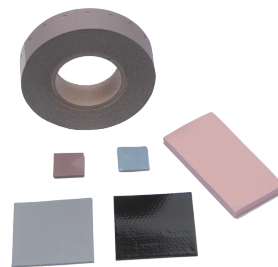


导热垫片

TIM-PAD Series



Tim -Pad是一种导热和绝缘硅基垫片。Tim -Pad清洁，绿色化生产，能有效替代云母、陶瓷或导热油脂，并将提供很好的保护免受变形，冲击或振动的损害。使用或不使用粘合剂均可，便于操作和安装。

典型应用 Typical Applications

功率晶体管，CPU或发热组件之间的接口。安装支架电气元件和电源隔离和/或从散热器的。隔离电气元件和电源远离散热器或安装支架。界面的离散半导体需要安装低压弹簧夹。医疗器械，军事和工业控制应用。

 TIMTRONICS THERMAL INTERFACE MATERIALS	1001	1002	1003	1041	Gel Pad
类型 Type	硅基 Silicone	硅基 Silicone	硅基 Silicone	硅基 Silicone	硅基 Silicone
增强材料 Reinforcement	玻璃纤维 Fiberglass	玻璃纤维 Fiberglass	玻璃纤维 Fiberglass	N/A	N/A
胶粘涂层 Adhesive Coating	可供应 Available	可供应 Available	可供应 Available	N/A	N/A
颜色 Color	灰色 Gray	棕色 Brown	白色 White	白色 White	灰色 Gray
比重 @25°C Specific Gravity	2.3	2.4	1.7	2.7	2.6
硬度(Shore A) Hardness	87	92	90	80	49 (Shore 00)
伸长率 Elongation (%)	> 2	> 2	> 3	65	15
拉伸强度 Tensile Strength. (PSI)	10,000	5,690	6,091	290	11,000
可燃性等级 Flammability	UL 94 V-0	UL 94 V-0	UL 94 V-0	UL 94 V-0	UL 94 V-0
可操作温度范围 Operating Temp Range	-40°C to 150°C	-40°C to 150°C	-40°C to 150°C	-40°C to 150°C	-40°C to 150°C
导热系数(W/m-K) Thermal Conductivity	1.1	1.6	3.0	4.1	1.6
热阻(°C-in ² /W) Thermal Resistance	0.55 (0.15mm Th)	0.55 (0.20mm Th)	0.31 (0.20mm Th)	0.12 (0.15mm Th)	0.39 (0.25mm Th)
击穿电压(KV /mm) Breakdown Voltage	11	6	11	12	5
介电常数(1KHz) Dielectric Constant	4.5	3.3	3.0	7.5	4.0
损耗因数(1KHz) Dissipation Factor	0.003	0.003	0.0005	0.052	0.003
体积电阻率(Ohm-cm) Volume Resistivity	1 × 10 ¹³	1 × 10 ¹³	1 × 10 ¹³	1 × 10 ¹³	1 × 10 ¹³
供应厚度(mm) Available Thickness	0.15, 2.0, 3.0	0.15, 0.20, 0.30	0.20, 0.30, 0.45, 0.85	0.20, 0.30, 0.45	0.25
供应面积 Availability	卷/张 Roll and sheets	卷/张 Roll and sheets	卷/张 Roll and sheets	卷/张 Roll and sheets	300mm×200mm